

MEAS

TE 内部编号 GA10K3CG582

TE 内部产品描述 CHPG-10K +/- 1% B 3976 +/- 2% BT3Lo-D

金电极 NTC 热敏电阻

[在 TE 官网查看>](#)
[传感器](#) > [温度传感器](#) > [NTC 热敏电阻传感器和探针](#) > [分离式 NTC](#) > [金电极 NTC 热敏电阻](#)
分离式 NTC 传感器类型: **无引线 NTC 金芯片**导线连接: **焊接/焊线**电阻 (25°C): **10 kΩ**电阻公差: **± 2 %, ± 2 %**Beta 25/85 值: **3976 K**[所有 金电极 NTC 热敏电阻 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式 NTC 传感器类型	无引线 NTC 金芯片
---------------	-------------

公差 β 值	±1 %
--------	------

信号特征

Beta 25/85 值	3976 K
--------------	--------

主体特性

导线连接	焊接/焊线
------	-------

使用环境

电阻 (25°C)	10 kΩ
-----------	-------

电阻公差	± 2 %, ± 2 %
------	--------------

分离式 NTC 环境温度范围	-40 – 125 °C
----------------	--------------

温度精确度	±1 @ 25 °C
-------	------------

最大温度	125 °C[257 °F]
------	----------------

包装特性

分离式 NTC 封装	金芯片热敏电阻
------------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





文档

数据表/目录页

[GOLD CHIP THERMISTOR GA10K3CG582](#)

[英文版本](#)